

# 第 55 回 電子デバイス実装研究委員会

日時：2025 年 11 月 11 日（火）13:00～16:10

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

## プログラム

---

司会 小幡 進 ((株)東芝)

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

『大電流パワーモジュールのための高信頼接合技術の研究』（40 分）

..... ○川城 史義（東芝デバイス&ストレージ株式会社）

13:50～14:30

『パワーデバイス向け放熱シートと銅ペースト』

..... ○柏崎 史（株式会社 ADEKA）

14:30～14:50 休 憩

司会 小原 さゆり（日本アイ・ビー・エム(株)）

14:50～15:30

『スポット冷却加熱装置を用いた熱負荷試験中の電子基板の 3 次元熱変形

およびサーモグラフィカメラ計測』（40 分）

..... ○菊池郁織、萩慶佑、田中浩和（エスベック株式会社事業開発部）

15:30～16:10

『実験データ・シミュレーションデータを活用した数理モデルの構築

およびモデルの逆解析による分子・材料・プロセスの設計』（40 分）

..... ○金子 弘昌（明治大学）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

---

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会